ICCS 2026

2026 International Conference on Circuits and Systems

Conference Awards

- ★ Young Scientist Award
- ★ Outstanding Organization Award
- ★ Best Paper Award
- ★ Best Oral Presentation Award
- ★ Best Poster Presentation Award

The 2026 International Conference on Circuits and Systems will be held in Hangzhou, China, from September 18 to 21, 2026. Since its inception in 2017, the conference has been successfully held for eight editions. ICCS 2026 is sponsored by Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University, hosted by State Key Laboratory of Spintronics/Yuhang Nano Center, and patroned by Fudan University (China), Auckland University of Technology(New Zealand), Zhejiang University (China), INAOE.

Hangzhou, China | September 18-21, 2026

Organizing Committee

ADVISORY CHAIR

- Amara Amara, Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University, China

CONFERENCE CHAIRS

- Weixin Gai, Peking University, China
- Wang Kang, Beihang University, China

CONFERENCE CO-CHAIRS

- Li Zhen, Hangzhou International Innovation Institute, Beihang University, China
- Nan Qi, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences (CAS), China
- Jing Jin, Shanghai Jiao Tong University, China

PROGRAM CHAIRS

- Letian Huang, University of Electronic Science and Technology of China, China
- Xunzhao Yin, Zhejiang University, China
- Bing Chen, Hangzhou Research Institute of Xidian University, China
- He Zhang, Beihang University, China
- Guennadi Kouzaev, Norwegian University of Science and Technology, Norway
- Fei Yuan, Toronto Metropolitan University, Canada
- Kaida Xu, University of Alcalá, Spain

PROGRAM CO-CHAIRS

- Chaoyue Zheng, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and Technology of China, Huzhou, China
- Srikrishna C. Bodepudi, Zhejiang University, China
- Esteban Tlelo-Cuautle, INAOE
- Sheng Ma, National University of Defense Technology, China

STEERING COMMITTEE

- Peter. Poechmueller, Shandong University, China

LOCAL CHAIR

- Junzhan Liu, Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University, China

WIE CHAIR

- Hua Fan, University of Electronic Science and Technology of China, China

TRACK CHAIRS

- Maliang Liu, Xidian University, China
- Gengen Liu, Fuzhou University, China
- Jixin Zhang, Hubei University of Technology
- Yibo Fan, Fudan University, China
- Zhao Zhang, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China
- Haoting Shen, Zhejiang University, China
- Zhangyong Chen, University of Electronic Science and Technology of China
- Guohua Zhou, Southwest Jiaotong University, China
- Dandan Ding, Hangzhou Normal University, China
- Yijiu Zhao, University of Electronic Science and Technology of China

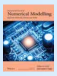
PUBLICITY CHAIRS

- Liuyang Zhang, Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University, China
- Shuman Mao, Yangtze Delta Region Institute of University of Electronic Science and
- Technology of China, Huzhou, China
- Yanlong Zhang, Xi'an Jiaotong University, China

EI Journal

Selected papers after extension will be recommended to the following journal:

Journal of Semiconductors
Indexing: Ei Compendex, ESCI, Scopus, INSPEC, CA, SA, AJ, CSTPCD, CSCD, WAJCI, etc.



International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields
Online ISSN:1099-1204
Indexing: SCI, EI Compendex, Scopus, etc

Computer Technology and Development (Monthly) ,
ISSN: 1673-629X

Journal of Electronic Science and Technology
ISSN: 1674-862X
Citescore Track: 2.7
Indexing: Ei Compendex, Scopus, INSPEC, CSCD, DOAJ etc., OA on ScienceDirect.

Submission

Online Submission System: *https://easychair.org/my/conference?conf=iccs2026*
Word Template Download: *https://iccs.org/files/conference-template-letter.docx*
Latex Template Download: *https://iccs.org/files/conference-latex-template.zip*
Submission Deadline: **June 20th, 2026**

Proceedings

IEEE

All papers submitted to ICCS that fall within IEEE technical scope will be published in the IEEE Conference Proceedings, which will be included in IEEE Xplore, and submitted for Ei Compendex & Scopus index after conference.

ICCS 2024 - ISBN: 979-8-3503-5214-6 | IEEE Xplore Online | Ei Compendex & Scopus index
ICCS 2023 - ISBN: 979-8-3503-0827-3 | IEEE Xplore Online | Ei Compendex & Scopus index
ICCS 2022 - ISBN: 978-1-6654-6036-1 | IEEE Xplore Online | Ei Compendex & Scopus index
ICCS 2021 - ISBN: 978-1-6654-1233-9 | IEEE Xplore Online | Ei Compendex & Scopus index
ICCS 2020 - ISBN: 978-1-7281-9121-8 | IEEE Xplore Online | Ei Compendex & Scopus index
ICCS 2017 - ISBN: 978-1-5090-6480-9 | IEEE Xplore Online | EI Compendex & Scopus index

Call for Papers

Track 1 Analog and Nonlinear Circuits Design

- Computing-in-Memory (CIM) and Analog AI Accelerators
- Nonlinear Dynamics for Secure Communications
- General Analog Circuits
- ADCs /DACs
- PLL & Clock Generators
- Chaos and Applications
- Dynamic Nonlinear Circuits

Track 2 VLSI Design & Electronic Design Automatic

- Hardware for AI/ML and Domain-Specific Accelerators
- 3D/2.5D Heterogeneous Integration and Chiplet-based Systems
- Hardware Security: PUF, TRNG, and
- Side-Channel Attack Countermeasures
- System Level Modeling & Verification
- High Level Synthesis
- Formal Verification
- Hardware/Software Co-Design
- Application Driven Accelerators Design & Domain-Specific Processor
- FPGA based Design & Heterogynous System

Track 3 Circuits and Systems for Signal Processing

- Computing-in-Memory (CIM) and Analog AI Accelerators
- Nonlinear Dynamics for Secure Communications
- General Analog Circuits
- ADCs /DACs
- PLL & Clock Generators
- Chaos and Applications
- Dynamic Nonlinear Circuits

Track 4 RF & Communication Circuits

- Millimeter-Wave and Terahertz (THz) Circuits for 6G/B5G
- Integrated Silicon Photonics for Optical Communication
- Over-the-Air (OTA) Testing and Calibration of AiP Modules
- Advanced RF Building Blocks
- Wireline Communication Interfaces
- Wireless Transmitters, Receivers, and Transceivers
- Circuits and Systems for Equalization, Synchronization & Channel Estimation
- Circuits and Systems for Coding and Modulation

More details: *https://iccs.org/cfp.html*

Track 5 Design for Test & Reliability

- Test and Reliability for AI Hardware and Secure Chips
- Aging Modeling and Mitigation in Advanced CMOS Nodes
- SoC Test Methodology
- Analog & Mixed Signal Circuits Test
- Fault Tolerant Design
- Aging Modeling & Mitigation
- Hardware Security

Track 6 Power Electronic Circuits

- Integrated Power Management and High-Efficiency Converters
- Circuits for Wireless Power Transfer and Energy Harvesting
- Distributed Circuits and Systems
- Power Line Analyzing & Modeling
- Energy Storage Circuits
- Energy Sources & Power Converter
- Circuits and Systems for Smart Grid

Track 7 Control Aspects of Circuits and Systems

- Control and Navigation for Autonomous Systems
- Adaptive and Learning-Based Control Systems
- Circuits and Systems for Automated Driving & Automated Vehicle
- Circuits and Systems for Motor Control
- Mechatronics
- Control Theory Application in Circuits and Systems
- Adaptive Circuits and Systems

Track 8 Circuits and Systems for Instrumentation and Measurement

- Smart Sensors and Sensor Fusion for IoT
- Fiber-Optic Sensing for Infrastructure and Biomedical Monitoring
- Direct Sampling Time-Domain Measurement Techniques
- Sensors and Sensor Interfaces
- Circuits and Systems for Instruments
- Circuits and Systems for Fault Detection & Diagnosis
- Circuits and Systems for Data Acquisition & Confusion
- Circuits and Systems for Measurement & Positioning

Sponsored by IEEE 杭州市北京航空航天大学国际创新研究院（北京航空航天大学国际创新学院） UESTC YDRI 电子科技大学长三角研究院（湖州）

Patrons AUT UNIVERSITY INAOE

Contact

Dr. Fidelia Lee E-mail: iccs@chairmen.org WeChat: iconf-ee-1

ICCS 2026

2026年电路与系统国际会议

会议奖项

- ★ 青年科学家奖
- ★ 优秀组织奖
- ★ 最佳论文奖
- ★ 最佳口头报告奖
- ★ 最佳海报展示奖

2026年电路与系统国际会议将于2026年9月18-21日在杭州召开，会议自2017年首次发起，至今已是第八届。本次会议由杭州市北京航空航天大学国际创新研究院（北京航空航天大学国际创新学院）和电子科技大学长三角研究院（湖州）联合主办，北航自旋芯片与技术全国重点实验室/微纳科学与分析测试协同创新中心承办，并得到了电子科技大学、复旦大学、新西兰奥克兰理工大学、浙江大学及墨西哥INAOE等高校和研究机构的支持。

2026年9月18至21日 | 中国，杭州

组委会

咨询主席

- Amara Amara，北京航空航天大学国际创新学院

大会主席

- 盖伟新，北京大学
- 康旺，北京航空航天大学

大会联合主席

- 李臻，杭州市北京航空航天大学国际创新研究院（北京航空航天大学国际创新学院）
- 祁楠，中国科学院半导体研究所
- 金晶，上海交通大学

程序委员会主席

- 黄乐天，电子科技大学
- 尹勋钊，浙江大学
- 陈冰，西安电子科技大学杭州研究院
- 张和，北京航空航天大学
- Guennadi Kouzaev，挪威科技大学
- Fei Yuan，加拿大多伦多都市大学
- 徐开达，西班牙阿尔卡拉大学

程序委员会联合主席

- 郑朝月，电子科技大学长三角研究院（湖州）
- Srikrishna C. Bodepudi，浙江大学
- Esteban Tlelo-Cuautle，INAOE
- 马胜，国防科技大学

指导委员会

- Peter. Poechmueller，山东大学

本地组织主席

- 刘均展，北京航空航天大学国际创新学院

WIE主席

- 樊华，电子科技大学

分会主席

- 刘马良，西安电子科技大学
- 刘耿耿，福州大学
- 张吉昕，湖北工业大学
- 范益波，复旦大学
- 张钊，中国科学院半导体研究所
- 沈浩颋，浙江大学
- 陈章勇，电子科技大学
- 周国华，西南交通大学
- 丁丹丹，杭州师范大学
- 赵贻玖，电子科技大学

宣传主席

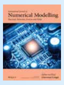
- 张留洋，北京航空航天大学国际创新学院
- 毛书漫，电子科技大学长三角研究院（湖州）
- 张岩龙，西安交通大学

EI 核心特刊

优秀论文拓展后有机会推荐至以下特刊：

半导体学报

Indexing: Ei Compendex, ESCI, Scopus, INSPEC, CA, SA, AJ, CSTPCD, CSCD, WAJCI, etc.



国际数值建模期刊：电子网络、器件与场

ISSN：1099-1204

Indexing: SCI, EI Compendex, Scopus, etc

《计算机技术与发展》（月刊）

ISSN: 1673-629X

中国计算机学会会刊

中国科技核心期刊；中国科技论文统计源期刊，RCCSE核心期刊

电子科技学刊

ISSN: 1674-862X

Citescore Track: 2.7

Indexing: Ei Compendex, Scopus, INSPEC, CSCD, DOAJ etc., OA on ScienceDirect.

投稿指南

在线投稿链接：*https://easychair.org/my/conference?conf=iccs2026*

投稿截止日期：**2026年6月20日**

会议论文集

IEEE 接收并注册的全文将由IEEE会议论文集出版，收录至IEEE Xplore，并于会后提交Ei核心和Scopus检索。

ICCS 2024 - ISBN: 979-8-3503-5214-6 | IEEE Xplore Online | (Ei 核心&SCOPUS 检索)
ICCS 2023 - ISBN: 979-8-3503-0827-3 | IEEE Xplore Online | (Ei 核心&SCOPUS 检索)
ICCS 2022 - ISBN: 978-1-6654-6036-1 | IEEE Xplore Online | (Ei 核心&SCOPUS 检索)
ICCS 2021 - ISBN: 978-1-6654-1233-9 | IEEE Xplore Online | (Ei 核心&SCOPUS 检索)
ICCS 2020 - ISBN: 978-1-7281-9121-8 | IEEE Xplore Online | (Ei 核心&SCOPUS 检索)
ICCS 2017 - ISBN: 978-1-5090-6480-9 | IEEE Xplore Online | (Ei 核心&SCOPUS 检索)

征稿主题

Track 1 模拟与非线性电路设计

- 内存计算（CIM）与模拟人工智能加速器
- 安全通信的非线性动力学
- 通用模拟电路
- ADC/DAC
- PLL 与时钟发生器
- 混沌与应用
- 动态非线性电路

Track 2 超大规模集成电路设计与电子设计自动

- 人工智能/机器学习和领域特定加速器的硬件
- 3D/2.5D异构集成与基于芯片组的系统
- 硬件安全：PUF、TRNG和侧信道攻击对策
- 系统级建模与验证
- 高级综合
- 形式验证
- 硬件/软件协同设计
- 应用驱动加速器设计与领域专用处理器
- 基于FPGA的设计与异向系统

Track 3 信号处理电路与系统

- 边缘人工智能和微型机器学习的电路与系统
- 可穿戴/植入设备的生物医学信号处理
- 高级图像传感与处理
- 图像处理电路与系统
- 音频与视频分析/识别/重建电路与系统
- 生物医学图像处理系统
- 身体与大脑接口
- 雷达信号处理电路与系统
- 信号检测电路与系统

Track 4 射频与通信电路

- 6G/B5G 的毫米波和太赫兹（THz）电路
- 集成硅光子学用于光学通信
- AiP模块的空中（OTA）测试与校准
- 先进的射频构建模块
- 有线通信接口
- 无线发射器、接收器和收发器
- 均衡、同步与通道估计电路与系统
- 编码与调制电路与系统

更多细节：*https://iccs.org/cfp.html*

Track 5 测试设计与可靠性

- 人工智能硬件与安全芯片的测试与可靠性
- 先进CMOS节点中的老化建模与缓解
- SoC 测试方法论
- 模拟与混合信号电路测试
- 容错设计
- 老化建模与缓解
- 硬件安全

Track 6 电力电子电路

- 集成电源管理与高效变流器
- 无线电力传输和能量收集电路
- 分布式电路与系统
- 电力线分析与建模
- 储能电路
- 能源与电力转换器
- 智能电网电路与系统

Track 7 电路与系统的控制方面

- Control and Navigation for Autonomous 自主系统的控制与导航
- 自适应与基于学习的控制系统
- 自动驾驶与自动驾驶的电路与系统
- 电机控制电路与系统
- 机电一体化
- 控制理论在电路与系统中的应用
- 自适应电路与系统

Track 8 仪器与测量电路与系统

- 物联网智能传感器与传感器融合
- 基础设施和生物医学监测的光纤传感
- 直接采样时域测量技术
- 传感器和传感器接口
- 仪器电路与系统
- 故障检测与诊断电路与系统
- 数据采集与混淆电路与系统
- 测量与定位电路与系统

Sponsored by IEEE　杭州市北京航空航天大学国际创新研究院（北京航空航天大学国际创新学院）　电子科技大学长三角研究院（湖州）

Patrons

联系方式

联系人：李老师　会议邮箱：iccs@chairmen.org　会议微信：iconf-ee-1